

## 中信证券股份有限公司 关于中微半导体(深圳)股份有限公司 2022年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称“中微半导体”或“公司”)首次公开发行股票并上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导暂行办法》等有关法律法规的规定,负责中微半导体上市后的持续督导工作,并就本持续督导年度跟踪报告公告。

### 一、持续督导工作内容

序号	工作内容	实施情况
1	是否按照行业规范履行督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制度已建立健全并有效执行了持续督导制度,并制定了相关的工作计划。	是
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始后,与上市公司董事会已就与保荐协议及保荐代表人协议的内容达成书面协议,并由双方共同遵守;持续督导期间的权限和义务。	是
3	通过日常沟通、定期回访、视频会议、走访调查等方式开展持续督导工作。	是
4	对持续督导期间,按照规定履行信息披露义务的上市公司进行必要的现场检查,并就检查结果向公司董事会和监事会报告。对于发现的问题,督促公司及时整改,并经公司书面确认后向公司董事会和监事会报告。	是
5	2022年度中微半导在持续督导期间未发生涉及违法违规事项的情况,保荐机构向其发送了合规风险提示函。	否
6	2022年度中微半导在持续督导期间未发生涉及违法违规事项的情况,保荐机构向其发送了合规风险提示函。	否
7	2022年度,高级管理人员遵循法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规章制度,勤勉尽责地履行了董事、监事、高级管理人员的职责。	是
8	2022年度,公司不存在违反《上市公司治理准则》的情形。	是
9	2022年度,公司不存在违反《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其董事、监事、高级管理人员在履行社会责任方面的特别规定》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规章制度,勤勉尽责地履行了董事、监事、高级管理人员的职责。	是
10	2022年度,公司不存在违反《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其董事、监事、高级管理人员在履行社会责任方面的特别规定》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规章制度,勤勉尽责地履行了董事、监事、高级管理人员的职责。	是
11	2022年度,中微半导及其董事、监事、高级管理人员不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到行政处罚,不存在被证券交易所公开谴责或通报批评,不存在被其他自律组织采取纪律处分的情况,并不存在尚未了结的诉讼、仲裁或调查。	是
12	2022年度中微半导不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未结案的情形。	否
13	2022年度,公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未结案的情形。	否
14	2022年度,公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未结案的情形。	否
15	2022年度,公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未结案的情形。	否
16	2022年度,公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未结案的情形。	否

### 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改措施

(一)重大事项风险	无
(二)业绩大幅下滑或亏损的风险	无
公司实现2022年度归属于母公司所有者的净利润5,917.73万元,同比下降92.46%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-61.02万元,同比下降87.65%,主要原因为公司2022年度营业收入和毛利均有明显下降。(2)公司布局大家电和汽车电子芯片市场,公司研发投入超1.2亿元,较上年度有较大幅度增长。	无
(三)核心竞争力风险	无
公司所处行业为技术密集型企业,公司研发投入的高底直接影响公司的竞争能力。目前公司正在逐步开拓新的客户,不断拓展研发人员,招聘聘请一批高素质高学历人才,在保障原有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发,努力缩短新产品的研发成果转化周期。	无
(四)产品研发风险	无
公司认为核心技术是公司,为适应市场新需求和新变化,坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计要求高、复杂度大,且周期长,若公司产品研发失败,存在前期投入资金无法收回的风险。	无
公司在从基础的主要研究项目包括家电主控芯片研发项目、车规级MCU系列芯片研发项目、基于5540纳米制程的芯片研发项目、下一代汽车系列项目、IGBT和半桥器件研发项目和电动汽车驱动IC研发项目等。上述新产品研发布局时间较长,资金投入较大,若公司在产品规划和研发过程中出现产品良率低、应用环境恶劣等情况,将对公司未来业绩造成一定影响。此外,若公司研发投入巨大且产品开发失败,导致公司市场竞争地位落后于行业,无法及时推出产品,技术人员流失,可能导致公司市场竞争地位产生一定影响。	无

### 三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改措施

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险	无
公司实现2022年度归属于母公司所有者的净利润5,917.73万元,同比下降92.46%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-61.02万元,同比下降87.65%,主要原因为公司2022年度营业收入和毛利均有明显下降。(2)公司布局大家电和汽车电子芯片市场,公司研发投入超1.2亿元,较上年度有较大幅度增长。	无
(三)核心竞争力风险	无
公司所处行业为技术密集型企业,公司研发投入的高底直接影响公司的竞争能力。目前公司正在逐步开拓新的客户,不断拓展研发人员,招聘聘请一批高素质高学历人才,在保障原有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发,努力缩短新产品的研发成果转化周期。	无
(四)产品研发风险	无
公司认为核心技术是公司,为适应市场新需求和新变化,坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计要求高、复杂度大,且周期长,若公司产品研发失败,存在前期投入资金无法收回的风险。	无
公司在从基础的主要研究项目包括家电主控芯片研发项目、车规级MCU系列芯片研发项目、基于5540纳米制程的芯片研发项目、下一代汽车系列项目、IGBT和半桥器件研发项目和电动汽车驱动IC研发项目等。上述新产品研发布局时间较长,资金投入较大,若公司在产品规划和研发过程中出现产品良率低、应用环境恶劣等情况,将对公司未来业绩造成一定影响。此外,若公司研发投入巨大且产品开发失败,导致公司市场竞争地位落后于行业,无法及时推出产品,技术人员流失,可能导致公司市场竞争地位产生一定影响。	无

### 四、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改措施

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险	无
公司实现2022年度归属于母公司所有者的净利润5,917.73万元,同比下降92.46%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-61.02万元,同比下降87.65%,主要原因为公司2022年度营业收入和毛利均有明显下降。(2)公司布局大家电和汽车电子芯片市场,公司研发投入超1.2亿元,较上年度有较大幅度增长。	无
(三)核心竞争力风险	无
公司所处行业为技术密集型企业,公司研发投入的高底直接影响公司的竞争能力。目前公司正在逐步开拓新的客户,不断拓展研发人员,招聘聘请一批高素质高学历人才,在保障原有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发,努力缩短新产品的研发成果转化周期。	无
(四)产品研发风险	无
公司认为核心技术是公司,为适应市场新需求和新变化,坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计要求高、复杂度大,且周期长,若公司产品研发失败,存在前期投入资金无法收回的风险。	无
公司在从基础的主要研究项目包括家电主控芯片研发项目、车规级MCU系列芯片研发项目、基于5540纳米制程的芯片研发项目、下一代汽车系列项目、IGBT和半桥器件研发项目和电动汽车驱动IC研发项目等。上述新产品研发布局时间较长,资金投入较大,若公司在产品规划和研发过程中出现产品良率低、应用环境恶劣等情况,将对公司未来业绩造成一定影响。此外,若公司研发投入巨大且产品开发失败,导致公司市场竞争地位落后于行业,无法及时推出产品,技术人员流失,可能导致公司市场竞争地位产生一定影响。	无

### 五、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改措施

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险	无
公司实现2022年度归属于母公司所有者的净利润5,917.73万元,同比下降92.46%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-61.02万元,同比下降87.65%,主要原因为公司2022年度营业收入和毛利均有明显下降。(2)公司布局大家电和汽车电子芯片市场,公司研发投入超1.2亿元,较上年度有较大幅度增长。	无
(三)核心竞争力风险	无
公司所处行业为技术密集型企业,公司研发投入的高底直接影响公司的竞争能力。目前公司正在逐步开拓新的客户,不断拓展研发人员,招聘聘请一批高素质高学历人才,在保障原有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发,努力缩短新产品的研发成果转化周期。	无
(四)产品研发风险	无
公司认为核心技术是公司,为适应市场新需求和新变化,坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计要求高、复杂度大,且周期长,若公司产品研发失败,存在前期投入资金无法收回的风险。	无
公司在从基础的主要研究项目包括家电主控芯片研发项目、车规级MCU系列芯片研发项目、基于5540纳米制程的芯片研发项目、下一代汽车系列项目、IGBT和半桥器件研发项目和电动汽车驱动IC研发项目等。上述新产品研发布局时间较长,资金投入较大,若公司在产品规划和研发过程中出现产品良率低、应用环境恶劣等情况,将对公司未来业绩造成一定影响。此外,若公司研发投入巨大且产品开发失败,导致公司市场竞争地位落后于行业,无法及时推出产品,技术人员流失,可能导致公司市场竞争地位产生一定影响。	无

### 六、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改措施

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险	无
公司实现2022年度归属于母公司所有者的净利润5,917.73万元,同比下降92.46%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-61.02万元,同比下降87.65%,主要原因为公司2022年度营业收入和毛利均有明显下降。(2)公司布局大家电和汽车电子芯片市场,公司研发投入超1.2亿元,较上年度有较大幅度增长。	无
(三)核心竞争力风险	无
公司所处行业为技术密集型企业,公司研发投入的高底直接影响公司的竞争能力。目前公司正在逐步开拓新的客户,不断拓展研发人员,招聘聘请一批高素质高学历人才,在保障原有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发,努力缩短新产品的研发成果转化周期。	无
(四)产品研发风险	无
公司认为核心技术是公司,为适应市场新需求和新变化,坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计要求高、复杂度大,且周期长,若公司产品研发失败,存在前期投入资金无法收回的风险。	无
公司在从基础的主要研究项目包括家电主控芯片研发项目、车规级MCU系列芯片研发项目、基于5540纳米制程的芯片研发项目、下一代汽车系列项目、IGBT和半桥器件研发项目和电动汽车驱动IC研发项目等。上述新产品研发布局时间较长,资金投入较大,若公司在产品规划和研发过程中出现产品良率低、应用环境恶劣等情况,将对公司未来业绩造成一定影响。此外,若公司研发投入巨大且产品开发失败,导致公司市场竞争地位落后于行业,无法及时推出产品,技术人员流失,可能导致公司市场竞争地位产生一定影响。	无

### 七、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改措施

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险	无
公司实现2022年度归属于母公司所有者的净利润5,917.73万元,同比下降92.46%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-61.02万元,同比下降87.65%,主要原因为公司2022年度营业收入和毛利均有明显下降。(2)公司布局大家电和汽车电子芯片市场,公司研发投入超1.2亿元,较上年度有较大幅度增长。	无
(三)核心竞争力风险	无
公司所处行业为技术密集型企业,公司研发投入的高底直接影响公司的竞争能力。目前公司正在逐步开拓新的客户,不断拓展研发人员,招聘聘请一批高素质高学历人才,在保障原有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发,努力缩短新产品的研发成果转化周期。	无
(四)产品研发风险	无
公司认为核心技术是公司,为适应市场新需求和新变化,坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计要求高、复杂度大,且周期长,若公司产品研发失败,存在前期投入资金无法收回的风险。	无
公司在从基础的主要研究项目包括家电主控芯片研发项目、车规级MCU系列芯片研发项目、基于5540纳米制程的芯片研发项目、下一代汽车系列项目、IGBT和半桥器件研发项目和电动汽车驱动IC研发项目等。上述新产品研发布局时间较长,资金投入较大,若公司在产品规划和研发过程中出现产品良率低、应用环境恶劣等情况,将对公司未来业绩造成一定影响。此外,若公司研发投入巨大且产品开发失败,导致公司市场竞争地位落后于行业,无法及时推出产品,技术人员流失,可能导致公司市场竞争地位产生一定影响。	无

### 八、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改措施

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险	无
公司实现2022年度归属于母公司所有者的净利润5,917.73万元,同比下降92.46%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-61.02万元,同比下降87.65%,主要原因为公司2022年度营业收入和毛利均有明显下降。(2)公司布局大家电和汽车电子芯片市场,公司研发投入超1.2亿元,较上年度有较大幅度增长。	无
(三)核心竞争力风险	无
公司所处行业为技术密集型企业,公司研发投入的高底直接影响公司的竞争能力。目前公司正在逐步开拓新的客户,不断拓展研发人员,招聘聘请一批高素质高学历人才,在保障原有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发,努力缩短新产品的研发成果转化周期。	无
(四)产品研发风险	无
公司认为核心技术是公司,为适应市场新需求和新变化,坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计要求高、复杂度大,且周期长,若公司产品研发失败,存在前期投入资金无法收回的风险。	无
公司在从基础的主要研究项目包括家电主控芯片研发项目、车规级MCU系列芯片研发项目、基于5540纳米制程的芯片研发项目、下一代汽车系列项目、IGBT和半桥器件研发项目和电动汽车驱动IC研发项目等。上述新产品研发布局时间较长,资金投入较大,若公司在产品规划和研发过程中出现产品良率低、应用环境恶劣等情况,将对公司未来业绩造成一定影响。此外,若公司研发投入巨大且产品开发失败,导致公司市场竞争地位落后于行业,无法及时推出产品,技术人员流失,可能导致公司市场竞争地位产生一定影响。	无

### 九、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改措施

(一)业绩大幅下滑或亏损的风险	无
公司实现2022年度归属于母公司所有者的净利润5,917.73万元,同比下降92.46%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-61.02万元,同比下降87.65%,主要原因为公司2022年度营业收入和毛利均有明显下降。(2)公司布局大家电和汽车电子芯片市场,公司研发投入超1.2亿元,较上年度有较大幅度增长。	无
(三)核心竞争力风险	无
公司所处行业为技术密集型企业,公司研发投入的高底直接影响公司的竞争能力。目前公司正在逐步开拓新的客户,不断拓展研发人员,招聘聘请一批高素质高学历人才,在保障原有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发,努力缩短新产品的研发成果转化周期。	无
(四)产品研发风险	无
公司认为核心技术是公司,为适应市场新需求和新变化,坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计要求高、复杂度大,且周期长,若公司产品研发失败,存在前期投入资金无法收回的风险。	无
公司在从基础的主要研究项目包括家电主控芯片研发项目、车规级MCU系列芯片研发项目、基于5540纳米制程的芯片研发项目、下一代汽车系列项目、IGBT和半桥器件研发项目和电动汽车驱动IC研发项目等。上述新产品研发布局时间较长,资金投入较大,若公司在产品	